



用途

半導体パッケージ

FC-xGA, Module, CSP,
FC-CSP

半導体パッケージ向け基板材料

LEXCMGX Series

半導体パッケージの薄型化・小型化、反り低減を実現

ラインアップ

パッケージ用途	FC-xGA	Module	CSP	FC-CSP
	• CPU for Server/Desktop/Laptop • GPU for AI/ADAS/Gaming • FPGA etc.	• AiP • PAM • FEM etc.	• DRAM • NAND • PMIC etc.	• APU • RF-IC etc.

製品	LEXCMGX	
	超低熱膨張 / 高信頼性	低熱膨張 / 極薄対応
	R-1515V / R-1515K • 低反り • 応力緩和 低熱膨張 / 高耐熱性 R-1515W • 低反り • 高弾性 R-1515A • 低反り • 高耐熱性	R-G515S / R-G515E • 低反り • 優れた積層加工性 • 極薄プリフレグ R-151YE • 低反り • 高弾性

一般特性

項目	ガラス転移温度 (Tg)	熱膨張係数 (タテ/ヨコ方向)	比誘電率(Dk)* ¹	誘電正接(Df)* ¹	曲げ弾性率* ¹	
		α l	1GHz			
試験方法	DMA* ²	社内法	IPC-TM-650 2.5.5.9		JIS C 6481	
条件	A	A	C-24/23/50		25℃	250℃
単位	℃	ppm /℃	－		GPa	
R-1515V	260	3-5	4.4	0.016	30	14
R-1515K	260	7	4.6	0.015	27	12
R-151YE	270	9	4.7	0.011	33	18
R-G515S	220-240	4-6	4.2	0.008	28	－
R-G515E	220-240	6-8	4.4	0.008	24	－
R-1515W	250	9	4.8	0.015	35	21
R-1515A	205	12	4.8	0.015	27	10

試験片の厚さは0.1mmです。

※1 0.8mm ※2 引張りモードでの測定、R-1515W、R-1515A:曲げモードでの測定

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

Panasonic Industry LEXCM GX

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

© Panasonic Industry Co., Ltd. 202608